

安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	泓德基金、睿远基金、易方达基金、中国人寿资产、高毅资产等 142 家机构，具体名单详见附件。
日期	2023 年 7 月 17 日
会议形式	电话会议
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书：邵森
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>鉴于近期投资者对于公司电子功能材料相关产品的关注度较高，为及时回应投资者关切，并进一步沟通公司近期经营情况，公司于 2023 年 7 月 17 日晚间会同多家券商分析师团队组织举行了近期经营情况交流会，就投资者关心的问题进行交流，相关记录如下：</p> <p>Q1：请介绍一下公司 Low-α射线球形氧化铝产品的技术来源和背景。</p>

A: 2006年,公司董事长结合自身在Low- α 射线二氧化硅领域的相关研究,设立壹石通公司。公司在初创阶段主要配合行业内技术领先、对材料要求严格的电子通信材料行业巨头日本雅都玛公司解决芯片封装的问题,为其开发出Low- α 射线高纯二氧化硅产品,进而形成稳定的合作关系。

公司成立以来,通过自主研发先后掌握了记忆体封装用Low- α 高纯石英及Low- α 高纯氧化铝制备技术、Low- α 粉体制备技术、球形化生产工艺等核心技术,而Low- α 射线球形氧化铝是在此基础上的产品升级。通过多年技术积累和工艺探索,公司已具备Low- α 射线球形氧化铝的产业化能力。

Q2: 请问公司Low- α 射线球形氧化铝产品相较竞争对手的优势?

A: 在芯片封装用Low- α 射线球形氧化铝领域,日本企业占领了全球市场大部分份额,国内应用主要依赖进口。目前全球能达到Low- α 射线控制及磁性异物控制,同时在形貌控制上可以实现纳米级产品的生产企业仍然较少。

公司Low- α 射线球形氧化铝采用自主知识产权的提纯技术和无放射性污染的球形化技术制备而成,兼具 α 射线含量低、球形化率高、磁性异物含量低、粒径分布可调、导热性好、体积填充率高等性能优势,将打破国外垄断,推动国内高端芯片封装材料的产业升级。

Q3: 请问 Low- α 射线球形氧化铝实现量产的主要难点和壁垒?

A: Low- α 射线球形氧化铝产品的生产难度大、技术壁垒高、工艺复杂,需同时兼顾控制 α 射线含量、球形化率、磁性异物含量、粒径分布、导热性、体积填充率等多项关键指标,且目前国内没有成套设备,公司已自研掌握了相关设备工艺技术,并参与了生产设备的设计及安装,成为全球少数能够量产 Low- α 射线球形氧化铝的制造商。

Q4: 请问公司 Low- α 射线球形氧化铝产品的下游客户拓展情况?

A: Low- α 射线球形氧化铝产品的下游客户主要集中在日本、韩国,目前公司对日韩客户均已陆续送样验证,客户初步反馈良好;对于国内的 EMC 客户,公司也已在对接产品验证工作。

Q5: 请问 Low- α 射线球形氧化铝产品市场空间如何?

A: 根据公司 2022 年披露的《向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复》,基于当时的市场调研情况,Low- α 射线球形氧化铝的市场需求量约为 1,000 吨/年,假设按照全球封测市场 3.89%年复合增长率(据 Frost & Sullivan)保守预测,至 2025 年 Low- α 射线球形氧化铝的市场规模约为 1,165 吨。近年来随着电子产品对安全性、精密性、智能

性的要求提升，以及 EMC（环氧塑封料）、GMC（颗粒状环氧塑封料）等高存储、高散热、高集成度的新应用场景出现，Low- α 射线球形氧化铝的下游应用需求增速有望加快。

Q6: 请问公司 Low- α 射线球形氧化铝主要有哪些应用场景？

A: 公司 Low- α 射线球形氧化铝产品主要作为高端芯片封装材料的功能填料，可应用于高算力、高集成度、异构芯片等高散热需求的封装场景，下游主要是大数据存储运算、人工智能、自动驾驶等领域。

Q7: 请问公司是否有布局 Low- α 球形二氧化硅产品？

A: 对于环氧塑封填料用 Low- α 球形二氧化硅产品，公司已经实现量产，但存量产能难以满足下游客户的需求预期，新产线正在推进建设中。

Q8: 请问 Low- α 球形二氧化硅产品特点和性能优势？

A: 公司球形二氧化硅产品主要作为芯片封装用环氧塑封料和高速覆铜板的功能填充材料，该产品具有高填充性、高绝缘性、低膨胀系数、高耐热性、高稳定性等优良性能。同时由于环氧塑封填料中的 U、Th 两种放射性同位素会释放 α 射线，从而引发电子芯片及线路板工作过程中发生软错误、影响其稳定性，因此芯片封装对于 α 射线的含量控制要求较高，Low- α 球形二氧化硅和 Low- α 球形氧化铝成为

高性能环氧塑封填料的主要选择。

Q9: 请问公司勃姆石产品近期经营情况如何?

A: 公司二季度排产情况与下游行业的回暖节奏整体一致, 产销有所提升。但由于上半年下游需求整体偏弱, 新增产能未完全释放, 叠加对部分客户售价下调, 勃姆石产品的盈利依然承压。公司以巩固提升市场份额作为首要目标, 下半年有望随着产能利用率提升、降本增效推进, 逐步修复盈利能力。

Q10: 请问公司 Low- α 产品可用做 GMC 封装材料吗?

A: 公司在芯片封装材料领域的主要产品是 Low- α 球形二氧化硅和 Low- α 球形氧化铝, 可作为 EMC (环氧塑封料) 和 GMC (颗粒状环氧塑封料) 的功能填充材料。

Q11: 请问公司 Low- α 球形氧化铝产品在 EMC 或 GMC 中的具体用量是多少?

A: 作为功能填充材料, Low- α 球形氧化铝粉体在 EMC (环氧塑封料) 或 GMC (颗粒状环氧塑封料) 中的体积填充率大约在 80%-90%。

附件

参与单位名单

附件：参与单位名单（排序不分先后）

泓德基金	睿远基金	易方达基金	中国人寿资产
高毅资产	嘉实基金	招商信诺资产	源乐晟资产
华夏基金	民生银行	长盛基金	汇添富基金
华夏未来	东兴基金	犁得尔私募	韶夏投资
汇百川基金	东证融汇	联创投资	申量基金
见合私募	沅京资本	隆象私募	慎知资产
健顺投资	富达基金	名禹资产	真滢投资
金建投资	富国基金	能投资本	盛宇股权
锦成盛资产	德汇集团	盘京投资	双安资产
旌安投资	高竹私募	磐泽资产	天虫资本
宝鸿投资	工银安盛	鹏华基金	天厚私募
诚昉投资	国际信托	鹏举投资	天倚道投资
创金合信基金	国鸣投资	前海联合基金	湍团投资
创钰投资	国寿安保	乾行资产	吴泽致远
琮碧秋实私募	国赞私募	勤辰私募	五地投资
大朴资产	禾永投资	青骊投资	希瓦私募
志开投资	华泰柏瑞	融通基金	熙山资本
华西基金	鸿道投资	渔洋私募	仙人掌私募
锐稳投资	鸿盛私募	煜诚私募	新活力资本
中欧基金	鸿运私募	源峰基金	鑫宇投资
中睿合银	华安基金	仓颉后实业	行必达私募
中邮人寿	胤胜资产	远望角投资	衍航投资
洲和资本	永禧永亿	大千华严	景星资产
棕榈湾投资	咏明资产	鼎萨私募	易米基金
兆天投资	涌乐股权	招银理财	银泰华盈
浙商基金	生命保险资产	花旗环球金融	FOUNTAIN BRIDGE
NTF Asset Management Limited		SINO LIFE ASSET MAN	
中金公司	国泰君安	天风证券	中信证券

财通证券	国元证券	东方证券	中银国际
海通证券	浙商证券	长江证券	东吴证券
光大证券	中信建投	信达证券	国泰证券
东海证券	红塔证券	银河证券	山西证券
国海证券	华福证券	英大证券	太平洋证券
国金证券	华泰证券	南京证券	中泰证券
国盛证券	华西证券	平安证券	中天国富
开源证券	西南证券	湘财证券	西部证券